



WORLD TRADE ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

Referencia: WLI/100

28 de febrero de 2006

**ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO  
HECHO EN MARRAKECH EL 15 DE ABRIL DE 1994**

**ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES  
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994**

**CERTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES  
DE LA LISTA LXCIV - HONDURAS**

ENVÍO DE COPIA AUTENTICADA

Tengo el honor de remitirle adjunta una copia autenticada de la Certificación de las Modificaciones y Rectificaciones de la Lista LXCIV - Honduras, con efecto a partir del **31 de enero de 2006**.

Pascal Lamy  
Director General

**LISTAS DE CONCESIONES ARANCELARIAS ANEXAS  
AL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES  
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994**

**CERTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES**

**LISTA LXCIV - HONDURAS**

CONSIDERANDO que las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 adoptaron, el 26 de marzo de 1980, una Decisión sobre los procedimientos para la modificación o rectificación de las listas de concesiones arancelarias (IBDD 27S/25).

CONSIDERANDO que, de conformidad con las disposiciones de la Decisión antes mencionada, se comunicó a todos los Miembros de la Organización Mundial del Comercio en el documento G/MA/TAR/RS/101 de 31 de octubre de 2005 un proyecto que contiene las modificaciones y rectificaciones de la Lista LXCIV - Honduras.

POR LA PRESENTE SE CERTIFICA que las modificaciones y rectificaciones de la Lista LXCIV - Honduras se han establecido de conformidad con la Decisión antes mencionada.

Las modificaciones y rectificaciones anexas surten efecto a partir del **31 de enero de 2006**.

La presente Certificación queda depositada en poder del Director General de la Organización Mundial del Comercio, quien remitirá sin dilación una copia autenticada a cada uno de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio, y será registrada de conformidad con las disposiciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

HECHA en Ginebra el veintisiete de febrero de dos mil seis.

Pascal Lamy

Copia autenticada:

Director General



# **SCHEDULE LXCV – HONDURAS**

**31 de enero de 2006**

<u>SAC2002</u>	<u>Descripción de los Productos</u>	<u>Tipo Base</u>	<u>Tipo Consolidado</u>	<u>Implementación</u>	<u>Instrum. en el que se establece la concesión actual</u>	<u>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</u>	<u>Demás Cargas y Derechos</u>	<u>Apénd. A - Sección 1</u>	<u>Apénd. A - Sección 2</u>	<u>Apénd. A - B</u>
					<u>DPN</u>					
3818.00.00	ELEMENTOS QUÍMICOS DOPADOS PARA USO EN ELECTRÓNICA, EN DISCOS, OBLEAS ("WAFERS") O FORMAS ANÁLOGAS; COMPUESTOS QUÍMICOS DOPADOS PARA USO EN ELECTRÓNICA.	35	0	2010	UR/94	HIN/94	0			1
7017	Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o calibrados.									
7017.10	- De cuarzo o demás sílices fundidos									
ex 7017.10.00	- Tubos de reactancia de cuarzo y soportes diseñados para su inserción en hornos de difusión y oxidación para la producción de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94	HIN/94	0			113
8419	Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento, excepto los aparatos domésticos; calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos.									
8419.8	- Los demás aparatos y dispositivos:									
8419.89	- - Los demás									

<b>SAC2002</b>	<b>Descripción de los Productos</b>	<b>Tipo Base</b>	<b>Tipo Consolidado</b>	<b>Implementación</b>	<b>Instrum. en el que se establece la concesión actual</b>	<b>DPN</b>	<b>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</b>	<b>Demás Cargas Y Derechos</b>	<b>Apénd. A - Sección 1</b>	<b>Apénd. A - Sección 2</b>	<b>Apénd. B</b>
ex 8419.89.00	-- Aparatos de deposición química de vapor para la producción de semiconductores.	15	0	2010	WT/Let/403	CE12	HN/94	0			114
8419.90	- Partes										
ex 8419.90.00	- Partes de los aparatos de deposición química de vapor para la producción de semiconductores.	15	0	2010	WT/Let/403	CE12	HN/94	0			115
8421	Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases.										
8421.1	- Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas:										
8421.19	-- Las demás										
ex 8421.19.00	--Secadoras centrifugas para la elaboración de discos (obleas) semiconductores	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			116
8421.9	- Partes:										
8421.91	-- De centrifugadoras, incluidas las de secadoras centrifugas										
ex 8421.91.00	-- Partes de las secadoras centrifugas para la elaboración de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			117
8424	Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares.										
8424.8	- Los demás aparatos:										
8424.89	-- Los demás										

<u>SAC2002</u>	<u>Descripción de los Productos</u>	<u>Tipo Base</u>	<u>Tipo Consolidado</u>	<u>Implementación</u>	<u>Instrum. en el que se establece la concesión actual</u>	<u>DPN</u>	<u>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</u>	<u>Demás Cargas y Derechos</u>	<u>Apénd. A - Apénd. A - Apénd. A - Apénd. B</u> <u>Sección 1 Sección 2 Sección 2 B</u>
ex 8424.89.00	-- Máquinas de rebabar para limpiar y eliminar los contaminantes de los hilos metálicos de salida de las estructuras de semiconductores antes del proceso de galvanoplastia.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0	118
ex 8424.89.00	-- Pulverizadores para atacar químicamente, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0	119
8424.90	- Partes								
ex 8424.90.00	-- Partes de los pulverizadores para atacar químicamente, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0	120
8456	Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma.								
8456.10	- Que operen mediante láser u otros haces de luz o de fotones								
ex 8456.10.00	- Máquinas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones en la producción de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0	121
8456.9	- Las demás:								
8456.91	-- Para grabar en seco esquemas (trazas) sobre material semiconductor.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0	123
ex 8456.91.00	-- Aparatos para atacar en seco, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0	122
8456.99	-- Las demás								

<b>SAC2002</b>	<b>Descripción de los Productos</b>	<b>Tipo Base</b>	<b>Tipo Consolidado</b>	<b>Implementación</b>	<b>Instrum. en el que se establece la concesión actual</b>	<b>DPN</b>	<b>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</b>	<b>Demás Derechos</b>	<b>Apénd. A - Sección 1</b>	<b>Apénd. A - Sección 2</b>	<b>Apénd. B</b>
ex 8456.99.00	-- Fresadoras de haces iónicos focalizados para la producción o reparación de máscaras y retículos utilizados como modelos en los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			124
ex 8456.99.00	-- Cortadoras por haz de láser para cortar las pistas de contacto en la producción de semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			125
8464	Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío.										
8464.10	- Máquinas de aserrar										
ex 8464.10.00	- Máquinas para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos o los discos (obleas) en microplaquitas.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			126
8464.20	- Máquinas de amolar o pulir										
ex 8464.20.00	- Máquinas de amolar, pulir y rodar para la elaboración de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			127
8464.90	- Las demás										
ex 8464.90.00	- Máquinas de fragmentación para marcar o ranurar los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			128
8466	Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas n°s 84.56 a 84.65, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo.										
8466.9	- Los demás:										